

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**HUA HONG SEMICONDUCTOR LIMITED**

**華虹半導體有限公司**

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：01347)

## 海外監管公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。

茲載列華虹半導體有限公司(「本公司」)於上海證券交易所網站刊發的《華虹半導體有限公司關於發行股份購買資產並募集配套資金暨關聯交易報告書(修訂稿)修訂說明的公告》，僅供參閱。

承董事會命  
華虹半導體有限公司  
董事會主席兼執行董事  
白鵬博士

中國上海，二零二六年五月二十九日

於本公告日期，本公司董事分別為：

**執行董事：**

白鵬(董事會主席兼總裁)

**非執行董事：**

葉峻  
孫國棟  
陳博  
熊承艷

**獨立非執行董事：**

張祖同  
王桂壩太平紳士  
封松林

证券代码：688347  
港股代码：01347

证券简称：华虹公司  
港股简称：华虹半导体

公告编号：2026-031

## 华虹半导体有限公司

# 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 报告书（修订稿）修订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

华虹半导体有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份方式向上海华虹（集团）有限公司、上海集成电路产业投资基金股份有限公司、国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司、上海国投先导集成电路私募投资基金合伙企业（有限合伙）购买其合计持有的华力微 97.4988% 股权（以下简称“本次交易”）。

公司于 2026 年 3 月 30 日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于受理华虹半导体有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的通知》（上证科审（并购重组）〔2026〕15 号），并于 2026 年 4 月 2 日收到上交所下发的《关于华虹半导体有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函》（上证科审（并购重组）〔2026〕16 号）（以下简称“《审核问询函》”）。

目前，公司完成了《审核问询函》相关问题的回复，独立财务顾问、会计师事务所、律师事务所、评估机构就《审核问询函》中的相关事项进行核查并发表明确意见，同时对 2026 年 3 月 30 日于上交所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《华虹半导体有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（申报稿）》予以修订，形成了《华虹半导体有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》（以下简称“《重组报告书（修订稿）》”）。

现将相关补充和修订的主要内容说明如下：

重组报告书章节	修订情况说明
释义	在“释义”中补充了专业名词释义
第四节 标的公司基本情况	在“第四节 标的公司基本情况”之“九、标的公司报告期会计政策及相关会计处理”之“（二）标的公司会计政策和会计估计

重组报告书章节	修订情况说明
	<p>与同行业或同类资产之间的差异及对拟购买资产利润的影响”中补充披露了标的公司各类业务具体收入确认政策，收入确认时点及相关依据，与同行业可比公司的差异</p> <p>在“第四节 标的公司基本情况”之“六、标的公司主营业务情况”之“（五）主要产品生产及销售情况”之“4、报告期内前五大客户销售情况”中补充披露了标的公司在报告期内向前五大客户销售的具体内容</p>
第六节 标的资产评估作价基本情况	在“第六节 标的资产评估作价基本情况”之“二、董事会对本次交易标的评估合理性及定价公允性分析”之“（六）定价公允性分析”补充披露了可比交易案例及相关分析
第九节 管理层讨论与分析	<p>在“第九节 管理层讨论与分析”之“二、本次交易标的行业特点和经营情况的讨论与分析”之“（七）行业竞争格局和行业内主要企业”中更新可比公司芯联集成、华润微、士兰微的 2025 年度财务数据</p> <p>在“第九节 管理层讨论与分析”之“三、标的公司的财务状况和盈利能力分析”之“（一）财务状况分析”和“（二）盈利能力分析”中将可比公司芯联集成、华润微、士兰微的财务数据及财务指标更新至 2025 年度/2025 年 12 月 31 日</p>
第十二节 风险因素	<p>在“第十二节 风险因素”之“二、与标的公司相关的风险”中补充披露了“（十）2024 年非经常性损益占比较高的风险”相关内容</p> <p>在“第十二节 风险因素”之“二、与标的公司相关的风险”中补充披露了“（十一）标的公司评估的相关风险”相关内容</p>

除上述修订和补充披露内容之外，上市公司已对《重组报告书（修订稿）》全文进行了梳理和自查，完善了少许数字或文字内容，对本次交易方案无影响。

特此公告。

华虹半导体有限公司董事会

2026年5月30日